

**FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR
ARBEITSWIRTSCHAFT UND ORGANISATION IAO**

FORUM UND KONFERENZ

Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung SSP 2019

AGILITÄT UND KOGNITIVES ENGINEERING

15. Mai 2019 | IndustrieForum

16. Mai 2019 | Wissenschaftliche Konferenz



SSP 2019

MITVERANSTALTER



Institut für Konstruktionstechnik
und Technisches Design
Universität Stuttgart



Universität Stuttgart
Institut für Arbeitswissenschaft und
Technologiemanagement IAT

VORWORT



Die Produktentwicklung steht vor großen Herausforderungen. Einerseits ändern sich Produkte in ihrer Charakteristik durch Trends wie Konnektivität, Künstliche Intelligenz, Biologisierung, Personalisierung oder Product-as-a-Service. Zum anderen verändern sich durch dieselben Trends auch die Werkzeuge und die Prozesse in der Produktentstehung und damit die Arbeit in der Produktentwicklung.

Agilität der Unternehmen und aller Akteure in den verteilten Wertschöpfungsnetzen ist unter den aktuellen Randbedingungen eine wichtige Voraussetzung, diese Herausforderungen zu meistern. Trotz allem Fortschritt bei der Digitalisierung der Produktentwicklung zeigen sich auch die Grenzen der digitalen Infrastrukturen und Werkzeuge. Um die Barrieren zwischen digitalen Insellösungen zu überwinden, sind kognitive Systeme bzw. Künstliche Intelligenz unabdingbar.

Bereits zum fünften Mal findet das SSP statt, nachdem die Symposien 2011, 2013, 2015 und 2017 mit jeweils über 200 Gästen aus Wissenschaft und Wirtschaft großen Zuspruch gefunden haben.



Das Fraunhofer IAO lädt Sie gemeinsam mit den Instituten für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT, für Konstruktionstechnik und Technisches Design IKTD und für Maschinenelemente IMA der Universität Stuttgart wieder ein, mit uns über neue Erkenntnisse und den Wandel in der Produktentwicklung nachzudenken und zu diskutieren.

Auf dem Industrieforum am ersten Tag präsentieren Vertreterinnen und Vertreter aus namhaften Unternehmen und aus der Forschung gemeinsam Strategien und teilen ihre Erfahrungen aus der Praxis.

International bekannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen auf der Konferenz am zweiten Tag ihre Ansätze und Forschungsergebnisse vor.



Nutzen Sie die Gelegenheit und erhalten Sie Einblick in spannende Best-Practice-Beispiele und erfolgreiche Strategien der Produktentwicklung. Wir freuen uns, mit Ihnen neue Ansätze zu diskutieren und den interdisziplinären Wissenstransfer zu gestalten!

Mit freundlichen Grüßen

Handwritten signature of Wilhelm Bauer in black ink.

Prof. Dr.-Ing. Prof. e. h. Wilhelm Bauer

Handwritten signature of Bernd Bertsche in black ink.

Prof. Dr.-Ing. Bernd Bertsche

Handwritten signature of Hansgeorg Binz in black ink.

Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Binz

Handwritten signature of Dieter Spath in black ink.

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e. h. Dr. h. c. Dieter Spath

Handwritten signature of Oliver Riedel in black ink.

Prof. Dr.-Ing. Oliver Riedel

PROGRAMMÜBERSICHT

Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung SSP 2019

Mittwoch, 15. Mai 2019 | Industrieforum

- 9.00 Uhr Plenarveranstaltung
 »Agilität und kognitives Engineering«
- 12.30 Uhr Forschung aktuell
- 14.00 Uhr Plenarveranstaltung
 »Agilität und kognitives Engineering«
- 17.00 Uhr Ende des Forums

Donnerstag, 16. Mai 2019 | Wissenschaftliche Konferenz

- 8.30 Uhr Begrüßung und Keynotes
- ab
- 10.30 Uhr Parallelstreams 1, 2 und 3
- 18.00 Uhr Ende der Konferenz

Weitere Einzelheiten zu den Themen der Sessions sowie zu den Vorträgen finden Sie nach dem Abschluss des Review-Prozesses auf der Konferenz-Webseite unter www.iao.fraunhofer.de/vk509.html

INDUSTRIEFORUM
MITTWOCH, 15. MAI 2019

8.30 Uhr Registrierung und Warm-up

9.00 Uhr Begrüßung und Einführung

Keynote

9.15 Uhr **Agilität und Cognitive Engineering –
die Zukunft der Produktentstehung**

*Prof. Dr. Oliver Riedel, Institutsleiter, Fraunhofer IAO,
Stuttgart*

Tandemvortrag

10.00 Uhr **Mass Personalization – so wird ein Schuh
draus**

*Jan Hill, Senior Director Technology
Innovation, adidas AG, Herzogenaurach und
Dr. Manfred Dangelmaier, Institutsdirektor,
Fraunhofer IAO, Stuttgart*

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr

Out of the box – Tandemvortrag

Biologische Transformation – Buzzword or Business?

Dr. Uwe Paulmann, Director Chemical Synthesis, Evonik Creavis GmbH, Marl und Prof. Martina Schraudner, Vorstandsmitglied, acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V., München

12.30 Uhr

Forschung aktuell

Elevator Pitches – Innovatives aus den Instituten

Moderation: Prof. Dr. Bernd Bertsche, Institutsleiter, IMA der Universität Stuttgart

13.00 Uhr

Mittagessen

14.00 Uhr

Out of the box – Tandemvortrag

XaaS – Wird das Produkt vollends zur Dienstleistung?

Prof. Dr. Martin Scherer, A+Videoclinic GmbH, Hamburg und Walter Ganz, Institutsdirektor, Fraunhofer IAQ, Stuttgart

INDUSTRIEFORUM
MITTWOCH, 15. MAI 2019

- 14.50 Uhr** **Tandemvortrag**
**Agiles Entwicklungsmanagement –
Transparenz und Agilität in der Entwicklung
von Triebwerkskomponenten**
*Dr. Daniel Greitemeier, Lean- & Prozesskoordinator,
MTU Aero Engines AG, München und
Dr. Philipp Oleinek, Geschäftsführender Gesellschafter,
EVOLUCONSULT GmbH, München*
- 15.30 Uhr** **Kaffeepause**
- 16.00 Uhr** **Tandemvortrag**
**Digitale Transformation – was treiben die
Champions?**
*Gerhard Baum, Chief Digital Officer, Schaeffler Techno-
logies AG & Co. KG, Herzogenaurach und
Prof. Dr. Volker Nestle, Head of Corporate Research,
TRUMPF GmbH + Co. KG, Ditzingen*
- 17.00 Uhr** **Ende der Veranstaltung**

WISSENSCHAFTLICHE KONFERENZ
DONNERSTAG, 16. MAI 2019

8.00 Uhr **Registrierung**

8.30 Uhr **Begrüßung und Einführung**

*Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Binz, Institutsleiter, IKTD der
Universität Stuttgart*

9.00 Uhr **Generative Engineering mit Fokus auf
bionischen Leichtbau**

*Dr. Moritz Maier, Gründer und Geschäftsführer,
ELISE GmbH, Bremerhaven*

9.30 Uhr **Best Paper-Vortrag**

10.00 Uhr **Kaffeepause**

10.30 Uhr **Parallelstreams 1**

12.00 Uhr **Mittagessen**

13.00 Uhr **Parallelstreams 2**

14.30 Uhr **Kaffeepause**

15.00 Uhr **Parallelstreams 3**

**WISSENSCHAFTLICHE KONFERENZ
DONNERSTAG, 16. MAI 2019**

16.35 Uhr Gemeinsamer Stream

16.50 Uhr Ausklang

18.00 Uhr Ende der Konferenz

ALLGEMEINE HINWEISE

FpF

Verein zur Förderung
produktionstechnischer Forschung e.V., Stuttgart

TAGUNGsort | Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO – Zentrum für Virtuelles Engineering ZVE, Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart

VERANSTALTER | Verein zur Förderung produktionstechnischer Forschung FpF e.V., Stuttgart und Fraunhofer IAO, Stuttgart

MITVERANSTALTER | Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design IKTD, Institut für Maschinenelemente IMA und Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT der Universität Stuttgart

KOOPERATIONSPARTNER | VDI Württembergischer Ingenieurverein e.V. und Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktentwicklung WiGeP e.V.



Württembergischer Ingenieurverein



Wissenschaftliche Gesellschaft
für Produktentwicklung WiGeP
Berliner Kreis & WGMK

ANMELDUNG | Die Anmeldung erfolgt unter:
www.iao.fraunhofer.de/vk544.html

ANMELDESCHLUSS | 6. Mai 2019

UMSCHREIBUNG DER ANMELDUNG | Die Umschreibung der Anmeldung auf einen anderen Teilnehmer/eine andere Teilnehmerin ist mitzuteilen und jederzeit kostenlos möglich.

ALLGEMEINE HINWEISE

TEILNAHMEGEBÜHR | Die Teilnahmegebühr beträgt 545 € pro Person für das Forum und 245 € pro Person für die Konferenz. Beide Tage können zum Gesamtpreis von 645 € pro Person gebucht werden. In den jeweiligen Gebühren enthalten sind die Teilnahme an den Vorträgen, Tagungsunterlagen (teilweise digital), das Mittagessen sowie die Erfrischungen während der Pausen.

STORNIERUNG | Bei Stornierung bis zum 15. April 2019 werden 75 € in Rechnung gestellt. Bei späterer Stornierung wird die volle Teilnahmegebühr berechnet.

VERANSTALTUNGSORGANISATION | Fraunhofer IAO, Veranstaltungsmanagement, Telefon +49 711 970-2080, event@iao.fraunhofer.de

INFORMATIONEN ZUM FORUM | Fraunhofer IAO, Dr. Manfred Dangelmaier, Telefon +49 711 970-2107, ssp2019@iao.fraunhofer.de

INFORMATIONEN ZUR KONFERENZ | IKTD der Universität Stuttgart, Daniel Roth, Telefon +49 711 685-60240, ssp2019@iao.fraunhofer.de

ANFAHRT | Eine Anfahrtsskizze, weitere organisatorische Details sowie die Rechnung erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung. Eine elektronische Anfahrtsskizze finden Sie im Internet unter www.iao.fraunhofer.de/anfahrt.